

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】令和 5 年 7 月 10 日(2023.7.10)

【公開番号】特開 2022-80022(P2022-80022A)

【公開日】令和 4 年 5 月 27 日(2022.5.27)

【年通号数】公開公報(特許)2022-094

【出願番号】特願 2020-190952(P2020-190952)

【国際特許分類】

H 0 1 M 50/50(2021.01)

H 0 1 M 50/572(2021.01)

H 0 1 M 50/20(2021.01)

10

【F I】

H 0 1 M 2/20 Z

H 0 1 M 2/20 A

H 0 1 M 2/34 B

H 0 1 M 2/34 A

H 0 1 M 2/10 M

【手続補正書】

20

【提出日】令和 5 年 6 月 30 日(2023.6.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0071】

実施形態 1 においては、ヒューズ部 60 を構成するためにチップヒューズ 61 を導電路 56 の端部に接続する工程が必要であった。しかし、本実施形態では、通常のフレキシブル基板の製造工程において、導電路 56 を形成する際にパターンヒューズ 161 (ヒューズ部 160) を構成することができ、効率的に回路基板 150 を製造することができる。

30

40

50